



NXP, Trimension™ UWB 기술로

삼성 갤럭시 스마트태그 플러스의 위치 탐지 정확도 대거 향상

2021년 6월 3일 - NXP 반도체는 컴퓨텍스(COMPUTEX) 행사에서 자사의 Trimension 초광대역(Ultra-Wideband, UWB) 플랫폼을 통해 스마트태그에 활용될 수 있는 파인 레인징(fine ranging) 기술을 소개했다. NXP는 UWB와 저전력 블루투스(Bluetooth® Low Energy) 솔루션을 새로운 삼성 갤럭시 스마트태그 플러스(SmartTag+)에 도입해 정확한 공간 인식 기능을 제공하고, 이로써 삼성 스마트싱스 파인드(SmartThings Find) 서비스 경험을 개선하도록 돕는다.

스마트싱스 파인드는 스마트싱스(SmartThings) 애플리케이션 내의 혁신적인 서비스다. 갤럭시 S21 플러스 및 S21 울트라를 포함한 일부 갤럭시 기기에서 사용할 수 있는 서비스로 사용자가 가장 중요한 물건을 근거리 혹은 원거리에서 찾을 수 있도록 도와주는 강력한 탐지 기능을 제공한다. 직관적인 추적 인터페이스를 통해 삼성 갤럭시 기기와 백팩, 지갑, 열쇠 등 갤럭시 스마트태그를 부착한 모든 개인 물품을 정확하게 찾을 수 있다. 그리고 이제 Trimension UWB와 저전력 블루투스가 적용된 갤럭시 스마트태그 플러스가 추가되면서 스마트폰의 카메라를 이용해 찾고 있는 물건을 시각적으로 안내하는 증강현실(augmented reality, AR) 기술을 활용할 수 있게 됐다.

UWB는 사용자가 개인 소지품의 위치를 인식할 수 있게 함으로써 사용자를 안심시켜 준다. 또한 UWB는 사물 간의 양방향 통신을 통해 새로운 경험을 예측하고, 자동화하며 실현 가능하게 하는 스마트 커넥티드 세상으로 한 걸음 더 다가갈 수 있게 해준다.

삼성전자 기술전략 그룹 송인강 상무는 "스마트싱스 파인드는 개인이 가장 좋아하는 물건을 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 간단하고 시각적 솔루션이다. 지도 및 사운드에 더해 AR이 활용되어 갤럭시 스마트태그 플러스가 부착된 기기를 찾아주는 장점이 추가되었고, 따라서 스마트싱스 파인드 경험이 훨씬 더 강력해졌다. 이는 사람들의 일상생활을 더 쉽고, 더 편리하고, 더 안전하게 만들어 준다. 스마트태그 플러스가 제공하는 혁신의 핵심은 물건의 위치를 더 정확하게 찾을 수 있게 해주는 NXP의 UWB 파인 레인징 기술"이라고 말했다.

라파엘 소토마요르(Rafael Sotomayor) NXP 반도체 커넥티비티 및 보안 부문 수석 부사장 겸 총괄은 "NXP의 Trimension 기술은 중요한 때에 정밀성을 제공하고 미래의 새로운 가능성을 열어준다. 정밀성과 보안성의 결합은 새로운 활용 사례의 기반이 되어준다. 갤럭시 스마트태그 플러스 분야에 대한 협업으로 삼성은 스마트싱스 생태계를 통해 편리하고 안전한 세상을 구현하겠다는 의지를 다시 한번 보여주었으며, NXP는 그 생태계의 일원이 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다.



- 갤럭시 스마트태그 플러스는 스마트싱스 앱에서 제공되는 스마트싱스 파인드 서비스를 통해 구동된다. 갤럭시 스마트태그 플러스는 현재 미국을 포함한 일부 시장에서 이용 가능하며, 곧 서비스 이용 가능 지역이 확대될 예정이다.
스마트싱스에 대한 자세한 내용은 <http://www.samsung.com/smarthings>에서 찾아볼 수 있으며, 갤럭시 스마트태그에 관한 내용은 여기에서 확인할 수 있다.
- NXP UWB IC, Trimension SR040은 스마트락(smart lock) 및 RTLS(실시간 위치 시스템) 태그와 같은 새로운 IoT 활용 사례를 지원하도록 최적화되어 매우 높은 정확도로 '상대 위치'를 제공한다.
- NXP QN9090 저전력 블루투스 마이크로컨트롤러(microcontroller)는 측파대(sideband) 통신, 구성 및 활성화를 위한 무선 인터페이스를 제공하여 UWB 활용 사례를 지원한다.

NXP의 UWB 생태계

업계에서 가장 광범위한 무선 기술 포트폴리오 중 하나를 보유한 NXP는 예측하고 자동화하는 커넥티드 세상이라는 비전을 가속화하기 위해 노력하고 있다. NXP는 시장에서 입증된 NXP의 임베디드 보안 요소(eSE) 및 NFC(근거리 무선 통신) 기술 통합을 기반으로, 포괄적인 소프트웨어 제품군과 강력한 보안 통합을 지원하는 시스템 레벨 UWB 솔루션을 최초로 제공했다. Trimension의 도입으로 NXP의 포괄적인 커넥티비티 제품군이 NFC, 와이파이, 5G, 블루투스까지 확대되었다. 자세한 내용은 www.nxp.com/uwb에서 확인할 수 있다.

NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 29,000명의 직원을 고용하고 있다. 2020년 매출은 미화 86억 1천만 불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.